

APLICACIÓN	TIPO DE FILM	ESPESOR (mils)	CARACTERÍSTICAS
Copper, Tin, Plating Print / Tent & Etch	Ordyl Alpha 300	1.2 (Alpha 330)	Gran resistencia a soluciones alcalinas.
		1.6 (Alpha 340)	Gran Resistencia a deposiciones de Níquel/Oro.
		2.0 (Alpha 350)	
		3.0 (Alpha 375)	
	Ordyl Alpha 800	1.0 (Alpha 825)	Gran flexibilidad y alta conformabilidad.
		1.2 (Alpha 830)	Fácil de estripar, con tamaño pequeño de partícula.
		1.6 (Alpha 840)	
		2.0 (Alpha 850)	
	Ordyl Alpha 900	0.8 (Alpha 920)	Gran flexibilidad y alta conformabilidad.
		1.2 (Alpha 930)	Buena polimerización.
		1.6 (Alpha 940)	Fácil de estripar, con tamaño pequeño de partícula.
		2.0 (Alpha 950)	
		2.4 (Alpha 960)	
	Ordyl AM 100	1.2 (AM 130)	Excelentes propiedades de adherencia.
		1.6 (AM 140)	Alta velocidad de insolado.
		2.0 (AM 150)	Gran flexibilidad y conformabilidad.
		3.0 (AM 175)	Resistencia a soluciones alcalinas.
	Ordyl AR 200S	1.6 (AR 240S)	Gran flexibilidad y conformabilidad.
		2.0 (AR 250S)	Resistencia a soluciones alcalinas.
	Ordyl FLR 4000	1.2 (FLR 4030)	Excelentes propiedades de adherencia.
1.6 (FLR 4040)		Alta velocidad de insolado.	
2.0 (FLR 4050)		Gran flexibilidad y conformabilidad.	
		Partícula muy pequeña en el estripado.	
Copper, Tin, Plating Print / Tent & Etch LDI Exposure	Ordyl Alpha 900NDI	0.8 (Alpha 920NDI)	No provoca residuos en el revelado.
		1.2 (Alpha 930NDI)	Muy buena polimerización, también con equipos LDI, y con espesores de film superiores a 50 micras.
		1.6 (Alpha 940NDI)	
		2.0 (Alpha 950NDI)	
		2.4 (Alpha 960NDI)	Fácil de estripar, con tamaño pequeño de partícula.
	Ordyl AM 100DI	0.6 (AM 115DI)	Excelente polimerización, también con equipos LDI, y con espesores de film superiores a 50 micras.
		0.8 (AM 120DI)	
		1.2 (AM 130DI)	
		1.6 (AM 140DI)	Excelentes propiedades de adherencia debidas a un promotor de adherencia especial.
		2.0 (AM 150DI)	Velocidad muy alta de insolado.
		2.4 (AM 160DI)	Gran flexibilidad y conformabilidad.
			Resistencia a soluciones alcalinas.
	Ordyl FLR 1000	1.2 (FLR 1030)	Excelente polimerización, también con equipos LDI con espesores de film superiores a 50 micras.
		1.6 (FLR 1040)	
		2.0 (FLR 1050)	

			<p>Excelentes propiedades de adherencia debidas a un promotor de adherencia especial.</p> <p>Alta velocidad de insolado.</p> <p>Gran flexibilidad y conformabilidad.</p> <p>Partícula muy pequeña en el estripado.</p>
Copper, Tin, Plating Print / Tent & Etch 405 nm LDI exposure	Ordyl AM 400	1.2 (AM 430)	Tiempos de insolado muy cortos trabajando a una longitud de onda de 405 nm.
		1.6 (AM 440)	
		2.0 (AM 450)	
	Ordyl AM 900	1.2 (AM 930)	Resistencia a soluciones alcalinas.
		1.6 (AM 940)	
		2.0 (AM 950)	
	Ordyl FLR 9000	1.2 (FLR 1030)	Tiempos de insolado muy cortos. Adecuado para trabajar con longitudes de onda UV estándar y de 405 nm.
		1.6 (FLR 1040)	
		2.0 (FLR 1050)	
			Partícula muy pequeña en el estripado.
Chemical Milling	Ordyl AF 200E	1.2 (AF 230E)	Excelente adherencia sobre acero inoxidable.
		1.6 (AF 240E)	
		2.0 (AF 250E)	
	Ordyl AF 200LDI	2.0 (AF 200 LDI)	Adecuado para equipos LDI.
			Excelente adherencia sobre acero inoxidable.
		Adecuado para equipos LDI.	
Chemical Milling Electroforming ENIG process	Ordyl NE 500	0.6 (NE 515)	Excelente adherencia sobre acero inoxidable.
		1.0 (NE 525)	
		1.6 (NE 540)	
		2.0 (NE 550)	
Ultra Fine Line	Ordyl FP 400	0.6 (FP 415)	Muy buena resistencia en proceso ENIG.
		1.0 (FP 425)	
		1.6 (FP 440)	
		2.0 (FP 450)	
	Ordyl FP 700	0.8 (FP 720)	<i>Ultra Fine Line</i>
		1.6 (FP 740)	
Packaging	Ordyl P-50000	4.0 (P50100)	Excelente resolución hasta 1:2 (por ejemplo, se puede conseguir una resolución de 20 micras con espesores de film de 40 micras).
		5.0 (P50125)	
Permanent resist for MEMS and Biochips Packaging	Ordyl SY 300	0.8 (SY 320)	Excelente polimerización incluso con espesores superiores a 100 micras.
		1.6 (SY 330)	
		2.2 (SY 355)	
			Excelente resistencia química.
			Biocompatible.
			Resistente al calor.
			Buena resolución.